

테크윙 (089030)

박장욱

jangwook.park@daishin.com

투자의견

N.R

6개월 목표주가

N.R

현재주가

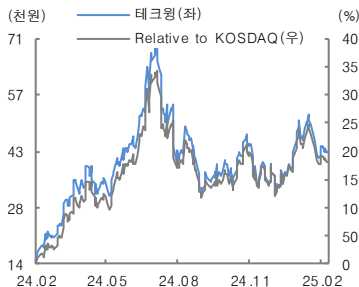
(25.02.19)

43,600

스물갑업종

KOSDAQ	768.48
시가총액	15,782억원
시가총액비중	0.42%
자본금(보통주)	190억원
52주 최고/최저	68,700원 / 18,200원
120일 평균거래대금	434억원
외국인지분율	15.48%
주요주주	나윤성 외 3인 13.58% 국민연금공단 5.10%

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-12.4	8.8	-13.6	132.1
상대수익률	-17.4	-3.0	-11.6	159.1



* C.O.K(Change Over Kit): 핸들러 내 검사 환경을 조성하는 소모성 부품(트레이)

큐브 프로버 장비로 레벨업

- 메모리 핸들러 장비사. C.O.K 매출을 통해 꾸준한 실적을 기록
- 신규 장비 큐브 프로버는 HBM 수율 개선에 기여할 것으로 기대됨
- 25년 큐브 프로버 매출 1,876억원으로 전체 실적 견인 예상

메모리 테스트핸들러 MS 70%의 세계 1위 사업자

동사의 주요 사업부문은 메모리 테스트핸들러(3Q24 누계 기준 매출비중 43%)와 C.O.K부문*(28%)으로 구성됨. 메모리 테스트 핸들러는 제조가 완료된 메모리 칩을 불량유무 및 생산등급에 따라서 분류해주는 역할을 하는 장비로, 테스터와 결합되어 사용됨. C.O.K는 핸들러 내에서 사용되는 소모성 부품으로 메모리 스펙 변경 시 마다 교체가 필요함. 메모리는 DDR4에서 DDR5로 세대 변화 등 지속적인 스펙 변화가 나타남. 이로 인해 C.O.K는 꾸준한 매출이 발생함.

신규 장비 큐브 프로버, HBM 수율 개선에 기대할 것으로 기대

큐브 프로버 장비는 동사의 주된 투자포인트임. 큐브 프로버 장비는 HBM제조 공정시 베이스 웨이퍼에 적층 디램을 결합후, 다이싱 과정에서 생기는 불량을 해소하기 위한 장비임. 베이스 웨이퍼에 디램을 적층하기 전에 다이싱을 진행함으로써 불필요한 테스트 과정을 줄이고, 완성된 HBM이 다이싱 과정에서 불량이 발생하는 것을 줄여주는 역할을 함. 올해 테크윙은 100 ~ 120 대의 장비 납품을 목표 중

25년 매출액 3,695억원 (+YoY 99%), 영업이익 883억원(+ 280%) 전망

25년 메모리 테스트 핸들러, C.O.K 및 기타 부문의 매출 1,697억원(+YoY 0.4%), 영업이익 327억원(+YoY 40%)로 레거시 부문 부진영향으로 매출 성장은 더디나, C.O.K부문 매출 성장에 따른 믹스 개선 효과가 날 것으로 기대됨. 신규 장비인 큐브 프로버 장비는 25년 매출 1,876억원, 영업이익 552억원으로 전사 실적의 큰 폭의 레벨업을 전망함. 큐브 프로버 장비는 올해 2월 삼성전자 PO완료로 현재 납품이 시작되고 있으며, SK하이닉스는 4월 ~ 5월, 마이크론은 6 ~ 7월부터 PO완료후 납품이 시작될 것으로 기대됨

영업실적 및 주요 투자지표

(단위: 억원, 원, %)

	2022A	2023A	2024A	2025F	2026F
매출액	2,675	1,336	1,855	3,695	5,613
영업이익	577	32	232	883	1,431
세전순이익	427	-129	-336	775	1,323
총당기순이익	332	-111	-225	605	1,032
지배지분순이익	326	-93	-218	593	1,022
EPS	900	-260	-611	1,658	2,859
PER	6.3	NA	NA	26.4	15.3
BPS	6,117	5,807	5,096	6,556	9,164
PBR	0.9	2.0	8.2	6.4	4.6
ROE	14.5	-4.2	-10.7	27.2	34.8

주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 테크윙, 대신증권 Research Center

테크윙 주요 사업부문

3Q24 매출 기준 테스트 핸들러 42%, C.O.K 32%,

24년 3Q24 누계 기준 메모리 테스트핸들러 43%, C.O.K 38%로 구성되어 있다. 동사의 메모리 테스트핸들러 사업부문은 디램 97%, 낸드 3%로 디램향 비중이 절대적이다. 메모리 핸들러 테스트 분야 세계 점유율 70%로 1위로 과점의 시장 지위를 보유하고 있다. 메모리 테스트 핸들러 부문의 마진율은 10 ~ 20% 수준이며, C.O.K는 30% 정도 수준이다.

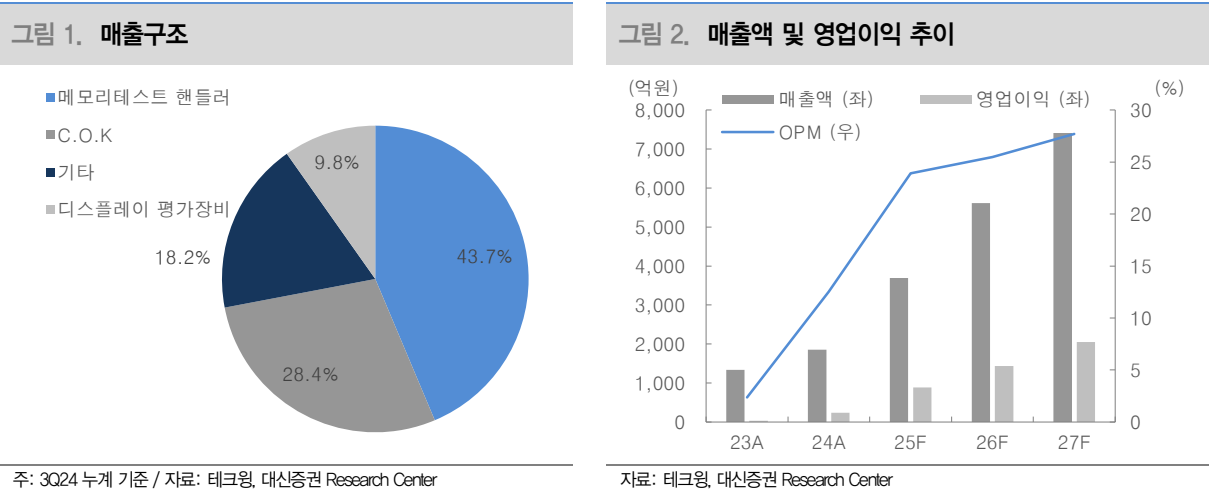


그림 3. 분기 및 연도별 실적추이 및 전망

(단위: 억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	23A	24A	25F	26F	27F
매출액	286	395	243	412	403	508	467	477	1,336	1,855	3,695	5,613	7,416
yoy	-44%	38%	-38%	69%	-2%	26%	-8%	2%	-50%	39%	99%	52%	32%
반도체 검사장비	275	364	181	324	342	453	448	447	1,144	1,690	3,573	5,499	7,329
테스트 핸들러	142	197	53	137	183	223	196	189	529	791	766	679	772
C.O.K	73	111	82	117	114	132	145	164	383	555	586	589	639
기타	61	56	46	70	45	98	108	94	233	345	345	314	299
큐브 프로버	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,876	3,917	5,619
디스플레이 평가	5	31	62	88	61	54	20	30	186	165	122	114	87
PCB 설계 등	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
매출총이익	121	155	90	130	160	202	187	176	495	726	1,870	2,891	3,871
yoy	-54%	-57%	-66%	-38%	33%	30%	107%	36%	-55%	47%	158%	55%	34%
매출총이익률	42%	39%	37%	32%	40%	40%	40%	37%	37%	39%	51%	52%	52%
영업이익	4	24	-27	30	56	72	62	43	32	232	883	1,431	2,054
yoy	-97%	-89%	-119%	-57%	1324%	195%	-330%	42%	-95%	635%	280%	62%	44%
영업이익률	3%	12%	-51%	22%	30%	32%	32%	23%	2%	13%	24%	26%	28%
세전이익	-80	-9	-131	91	-106	-28	178	-380	-129	-336	775	1,323	1,946
yoy	-166%	-108%	67%	-67%	33%	220%	-236%	-517%	-130%	161%	-331%	71%	47%
세전이익률	-28%	-2%	-54%	22%	-26%	-6%	38%	-80%	-10%	-18%	21%	24%	26%
당기순이익	-62	-4	-113	86	-83	-11	146	-271	-93	-218	593	1,022	1,503
yoy	-164%	-105%	63%	-59%	33%	158%	-230%	-414%	-129%	135%	-371%	72%	47%
당기순이익률	-22%	-1%	-46%	21%	-20%	-2%	31%	-57%	-7%	-12%	16%	18%	20%

자료: 대신증권 Research Center 추정

꾸준한 실적이 기대되는 테스트 핸들러 및 C.O.K 시장

메모리 테스트 핸들러
사업부 점유율 70%

현재 동사의 주요 사업부는 테스트 핸들러 및 C.O.K(Change Of Kit)이다. 테스트 핸들러는 메모리 핸들러와 비메모리 핸들러로 나누어져 있다. 동사는 메모리 테스트 핸들러 시장점 점유율 70%로 글로벌 1위 회사이다. 메모리 3사 중 삼성전자를 제외한 SK하이닉스, 마이크론에 장비를 납품 중이며, 삼성전자는 세메스를 통해서 테스트 핸들러를 납품받고 있다.

핸들러는 테스트와 결합하여 칩을 분류하는 역할을 함

반도체 칩은 라인별로 같은 공정을 채택했다고 하더라도 칩의 성능이 다르게 생산되기 때문에 등급에 따른 분류과정이 꼭 필요하다. 테스트 핸들러는 반도체 후공정 최종 테스트 단계에서 패키징이 완료된 칩을 주검사 장치(테스터)로 자동 이송 하고, 설정된 테스트 온도 환경을 제공한 뒤 테스트 결과에 따라 양품/불량품/등급별로 반도체를 분류한다.

테스터 회사는 테스터와 핸들러의 단가 차이 등으로 핸들러를 제조하지 않음.

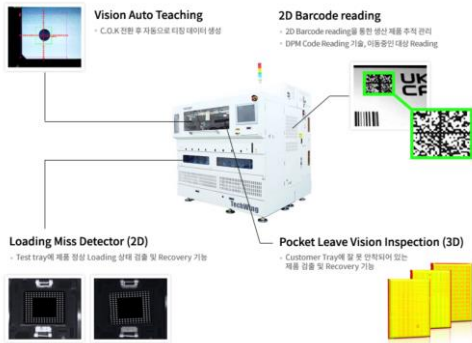
실질적인 테스트는 테라다인 혹은 어드반테스트의 테스터 장비가 수행하며, 동사의 핸들러는 핸들러 - Interface Board- 테스터가 결합되어서 함께 납품된다. 테스터 장비는 대당 40 ~ 50억원인 반면, 핸들러 장비는 대당 4 ~5억원 수준이다. 장비의 단가 및 AS 측면에서 테스터 회사가 핸들러까지 턴키로 제조하는 것이 유리하지 않아, 동사의 테스터가 시장을 과점하고 있는 상황이다. 동사는 경쟁사와 비교해서 핸들러 안의 온도제어(챔버)와 핸들링 기술이 뛰어나 경쟁사대비 높은 점유율을 보유하고 있다.

메모리 스펙 변경에 따라 꾸준한 매출이 발생하는 C.O.K 부문

동사 매출에서 특이한 점은 C.O.K(Change Over Kit)다. C.O.K는 일종의 칩을 담아서 운반하는 그릇과 같은 개념이다. 기본적으로 소모품 성격을 가지고 있어, 0.5년 ~ 2년 주기로 교체가 필요하다. 메모리 반도체는 칩의 성능이 바뀌게 되면, 다른 종류의 C.O.K가 필요하기 때문이다.

이러한 성격으로 인해서 메모리 테스트 핸들러 장비가 고객사에 많이 납품이 되어 있을 수록, C.O.K 매출은 누적적으로 증가하는 성격을 지니고 있다. 테스트 핸들러 장비는 칩의 스펙 변화에도 개선을 통해서 지속적으로 사용이 가능한 반면, C.O.K는 메모리 반도체의 스펙 변화에 따라 지속적인 변경이 필요하기 때문이다.

그림 4. 테크윙 메모리 테스트 핸들러 장비



자료: 테크윙, 대신증권 Research Center

그림 5. 핸들러 장비 및 테스터 장비



자료: 테크윙, 대신증권 Research Center

실적 레벨업을 만들 신규 장비 큐브 프로버

신규 장비 큐브 프로버

동사 사업에서 기대할 부문은 신규 장비인 ‘큐브 프로버’다. 반도체는 웨이퍼에서 제조되어서 개별로 분해되는 싱글레이션 과정을 거쳐 다이로 만든 다음에 이후, 패키징 공정을 거쳐서 칩으로 만들어지게 된다.

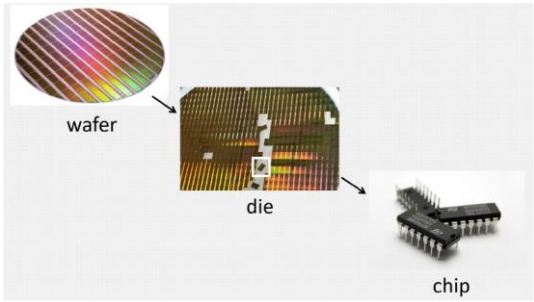
후공정 칩의 이송과 달리 웨이퍼 부문의 테스트를 담당하는 프로버 장비

기존에 동사가 영위하고 있던 사업은 제조가 완료된 칩을 분류하고 이동해주는 핸들러 장비인 반면, 신규 장비인 큐브 프로버는 웨이퍼 단계에 있는 완성되기 전 단계의 반도체를 이송해주는 역할을 한다.

동사 장비의 특별한 점을 이해하기 위해서는 HBM의 기본적인 제조 공정에 대한 이해가 필요하다. 기존의 웨이퍼 레벨 테스트, 다이싱, 패키징을 통해 칩으로 제조하는 과정과 달리 HBM은 로직다이와 디램 다이를 따로 제조하여서 적층하는 과정으로 제조되기 때문이다.

그림 6. 동사 제조 큐브 프로버

그림 7. 반도체 제조 프로세스



자료: 테크윙, 대신증권 Research Center

자료: 산업자료, 대신증권 Research Center

기존의 HBM 제조방식과 발생하는 비효율성

HBM의 제조과정. 로직다이를 제조함

HBM은 컨트롤러 등의 역할을 하는 로직 다이와 일반 디램이 적층된 다이가 접합되는 형태로 만들어진다. 우선, 로직 다이를 제조한다. 로직 다이는 웨이퍼 레벨에서 테스트가 이루어진다. 검사가 끝난 로직다이를 베이스 웨이퍼라고 한다. 이후, 적층 디램을 준비한다.

개별 DRAM을 생산한 뒤, TSV 공정을 거쳐서 적층 DRAM을 만듦

DRAM의 적층은 다음의 과정을 통해서 제조된다. 우선, 개별 디램들을 제조한다. 이들 중 양질의 DRAM을 선정한다. 이들은 KGD(Known Good Die)로 분류된다. KGD에 TSV*공정을 적용한다. TSV는 적층된 디램간의 원활한 전자 신호의 소통을 위해 In & Out (I/O)단자를 디램간의 만드는 과정이다.

완성된 로직다이에 적층 DRAM을 접합해서, HBM을 완성함

TSV까지 적용된 KGD들을 적층하여 적층 DRAM을 만든다. 적층 중간 과정에서도 테스트가 이루어진다. 원하는 단수의 적층이 완료되면, 테스트를 진행하는데, 테스트가 완료된 적층 디램들은 KGSD(Known Good Stacked Die)으로 분류된다.

기존 공정의 문제점
1.베이스 웨이퍼를 활용해 비효율성이 발생하는 기존 공정

이후, 제조가 완료된 로직 다이인 베이스 웨이퍼에 적층된 디램을 접합하여 HBM을 제조한다. 베이스 웨이퍼에 디램을 적층한 뒤에 완성된 칩을 다이싱 해서 파이널 테스트를 해서 출하한다. 그렇게 이송된 HBM을 TSMC가 COWS 패키징을 통해 인터포저에 GPU와 HBM을 접합해서 AI칩을 완성해 고객사에 납품한다. HBM에서 불량 발생시, AI칩 전체의 불량으로 이어지기 때문에 일반 디램보다 높은 신뢰도가 요구된다.

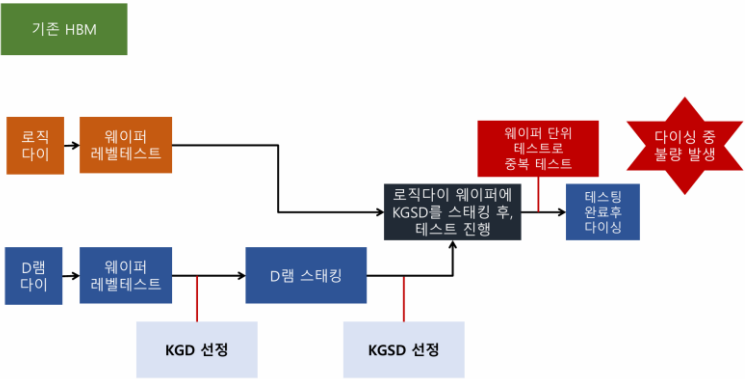
2.베이스 웨이퍼의 다이싱 과정에서 불량이 발생함.

기존의 HBM 제조과정에서는 두 가지 문제점이 있다. 첫 째, 테스트과정에서의 비효율성이다. HBM의 제조에서 웨이퍼에서 다이싱 되지 않은 베이스 웨이퍼에 KGSD를 접합한 뒤, 이후 테스트가 이루어진다. 이 과정에서 불량 발생하여 탈락하는 다이들이 발생하더라도 전체 테스트 공정을 모두 다 함께 진행해야 해서 비용의 누수가 발생한다.

둘 째, 다이싱 과정에서의 불량품 발생이다. 모든 테스트 과정을 거치더라도 웨이퍼에 아직 붙어있는 상황에서 다이싱을 해야 하는데, 적층까지 모두 완료된 상황에서 다이싱시에 불량이 발생할 수 있다.

이 두 가지 문제점을 해결할 수 있는 것이 동사의 ‘큐브 프로버’다.

그림 8. 기존 HBM의 제조과정

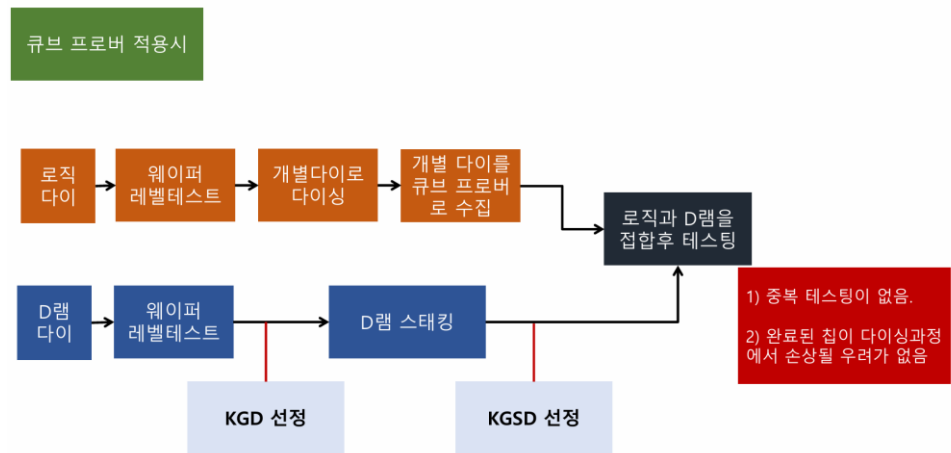


자료: 산업자료, 대신증권 Research Center

기존 HBM 과 다른 큐브 프로버 장비

큐브 프로버 장비의 장점	큐브 프로버 장비를 이용하면, 웨이퍼 레벨 테스트가 끝난 베이스 웨이퍼를 다이싱해서 웨이퍼에서 떼어내게 된다. 그리고 이들을 테크윙이 제조한 일종의 그릇 개념의 척에 칩을 옮긴다. 이후, 캐리어 웨이퍼에 있는 로직다이에 KGSD를 접합해서 HBM을 제조하게 된다.
1.베이스 웨이퍼에서 불량이 났던 반도체를 계속 테스트 하던 문제를 해결함	이를 통해서, 첫 째, KGSD가 접합된 베이스 웨이퍼에서 테스트가 중복되었던 비효율성을 줄일 수 있다. 기존의 방식은 베이스 웨이퍼에 다이싱을 하기 전에 테스트가 진행되었기 때문에, 베이스웨이퍼에서 불량이 발생하더라도 모든 테스트 공정이 진행될 수 밖에 없었다. 큐브 프로버 장비를 활용시, 다이 단위에서 척에서 불량 칩을 떼어내면 되기 때문에, 효율성이 개선된다.
2.완성된 HBM의 다이싱 과정에서 생기는 문제를 해소함.	둘 째, 테스트까지 완성된 HBM을 웨이퍼에서 다이싱 하는 과정에서 생기는 불량을 줄일 수 있다. 기존에는 베이스웨이퍼에 KGSD를 접합하고 모든 테스트까지 완료되더라도 다이싱하는 과정에서 손상이 발생해 불량이 생길 수 있었다. 큐브 프로버는 접합 전에 다이싱을 함으로써 이 문제를 해결할 수 있다.
비전 기술과 정렬기술이 동시에 필요한 큐브 프로버 장비	기존의 HBM 제조 과정에서 로직 다이를 베이스 웨이퍼에서 먼저 다이싱 하지 못 한 것은 다이싱한 로직 다이를 다시 정밀하게 척에 옮기고 비치시키는 기술력이 부족했기 때문이다. 이를 위해서는 다이싱된 다이를 정밀하게 정렬하는 기술과 이를 정밀하게 검사하는 비전 기술이 있어야 한다. 현재는 관련해서 테크윙만 유일하게 해당 기술을 보유하고 있는 상황이다. 현재 HBM시장은 수율을 개선하고 있는 초기 단계로 테스트 부문에서의 장비 투자가 지속적으로 주목받을 것으로 예상된다. 테스트를 통해서 불량칩 검출뿐 아니라 공정에서의 수율 개선을 이뤄낼 수 있기 때문이다. 그런 점에서 동사의 큐브 프로버 장비는 지속적으로 관심을 받을 것으로 기대한다.

그림 9. 큐브 프로버 장비 적용시의 HBM 제조과정



자료: 산업자료, 대신증권 Research Center

앞으로 계속될 AI / HPC 투자

딥시크 사태로 초래된
AI 투자 중 HW의 비
중 감소 우려

최근에 붙어진 딥시크 이슈는 AI HW에 대한 투자 지속성에 대한 의문을 초래하였다. 이는 AI와 관련한 투자의 지속성 보다는 빅테크의 자본 지출에서 HW가 차지하는 비중이 감소할 수 있다는 우려가 부각된 것이다.

AI 대중화에서 일어나
는 자연스러운 사건

해당 이슈는 기술의 대중화에서 발생하는 자연스러운 일이라는 판단이다. AI가 대중화되기 위한 가장 필요한 조건 중 하나는 비용이 저렴해지는 것이고, 딥시크와 같이 모델 경량화 작업은 이전에도 이루어져 온 일이기 때문이다. AI 모델의 경량화뿐 아니라 NVIDIA 칩을 포함해 HBM의 높은 가격으로 인해 원가절감을 위한 노력들도 이루어질 것이다.

동사 큐브 프로버 장
비는 HBM의 비용 개
선을 위한 장비라는
측면에서 채택을 확대
로 나타날 것

결국, 메모리 반도체도 비트당 가격이 비약적으로 감소함에 따라서 사용처가 확대되어 왔다는 것을 기억할 필요가 있다. 동사의 큐브 프로버 장비도 HBM의 수율 개선을 통해 비용 개선을 하는 것이 목적이 있다. HBM도 필요성은 크지만 현재도 비싸기 때문에 많이 사용되지 못하고 있을 따름이다. HBM의 비용 개선 필요성이 높아 질수록 동사 장비 채택의 필요성 역시 점차 확대될 것이다.

AI HPC에 대한 투자는 지금의 언어 LLM뿐 아니라 비디오 LLM을 넘어 AGI까지 발전해나가는 과정에 있다. 또, 자율주행, 로봇으로 이어지는 AI의 발전과정에서 AI HPC에 대한 수요는 앞으로도 계속될 것이다.

실적추정

C.O.K의 매출 성장으로 기존 사업부의 소폭의 영업이익의 성장 전망

동사의 실적 부문은 크게 두 부문으로 구성되어 있다. 테스트핸들러 및 C.O.K 부문이 포함된 기존 사업부와 신규 장비인 큐브 프로버 장비다. 기존 사업부의 경우는 레저시디램 시장의 정체에 따라서 메모리 테스트핸들러 부문 매출은 정체된 가운데, C.O.K 부문의 매출은 꾸준히 발생할 것으로 예상한다.

메모리 테스트 핸들러, C.O.K 및 기타 사업부문을 포함한 기존 사업부의 25년 매출액 1,697억원(+YoY 0.4%), 영업이익 327억원(+YoY 40%)을 전망한다.

25년 큐브 프로버 장비의 순차적인 납품이 기대됨

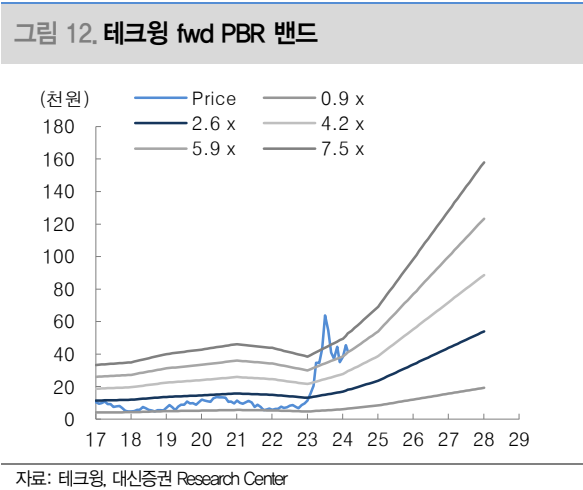
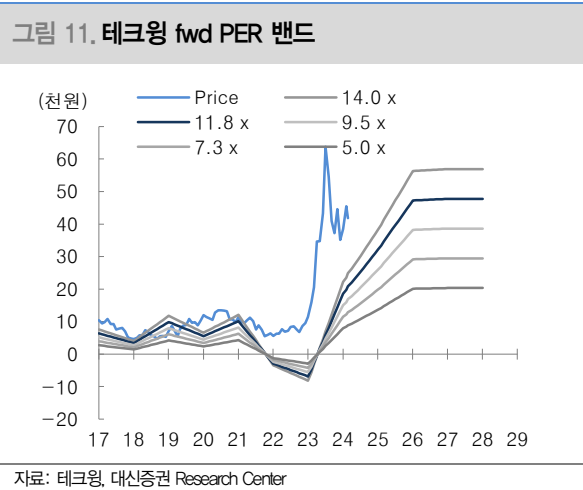
큐브 프로버 장비는 올해 2월 삼성전자향 PO가 완료됨에 따라 순차적인 장비 납품이 진행 중이다. SK하이닉스는 4월 ~ 5월, 마이크론은 6 ~ 7월부터 PO완료후 납품이 시작될 것으로 기대된다. 25년 큐브 프로버 장비의 매출액 1,876 억원, 영업이익 552억원을 전망한다.

그림 10. 주요 메모리 3 개사 HBM 생산량 전망

(단위: K*)

	24A	25E	26E	27E
삼성전자	120	150	200	300
하이닉스	130	170	200	280
마이크론	30	45	60	90

주: 월간 웨이퍼 출하 대수, 천 장 단위, 자료: 대신증권 Research Center 추정



재무제표

포괄손익계산서	(단위: 억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
매출액	2,675	1,336	1,846	3,774	5,613
매출원가	1,580	841	1,109	1,816	2,702
매출총이익	1,094	495	737	1,958	2,911
판매비와관리비	518	464	486	981	1,459
영업이익	577	32	251	976	1,452
영업이익률	21.6	2.4	13.6	25.9	25.9
EBITDA	689	134	372	1,116	1,609
영업외손익	-149	-160	-130	-130	-130
관계기업손익	0	0	0	0	0
금융수익	30	39	10	10	10
외환관련이익	133	21	21	21	21
금융비용	-118	-65	-6	-6	-6
외환관련손실	51	8	6	6	6
기타	-62	-134	-134	-134	-134
법인세비용차감전순손익	427	-129	121	846	1,322
법인세비용	-95	18	-27	-186	-291
계속사업순손익	332	-111	94	660	1,031
중단사업순손익	0	0	0	0	0
당기순이익	332	-111	94	660	1,031
당기순이익률	12.4	-8.3	5.1	17.5	18.4
비배지분순이익	6	-18	3	13	10
지배지분순이익	326	-93	91	647	1,021
매도가능금융자산평가	0	0	0	0	0
기타포괄이익	-8	-8	-9	-9	-9
포괄순이익	324	-119	85	651	1,022
비배지분포괄이익	7	-19	3	13	10
지배지분포괄이익	317	-101	83	638	1,012

Valuation 지표	(단위: 원, 배, %)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
EPS	900	-260	255	1,809	2,856
PER	6.3	NA	150.6	23.3	14.7
BPS	6,117	5,807	5,925	7,529	10,135
PBR	0.9	2.0	7.1	5.6	4.2
EBITDAPS	1,820	360	997	2,987	4,307
EV/EBITDA	5.7	47.8	48.6	17.1	12.2
SPS	7,064	3,577	4,941	10,103	15,027
PSR	0.8	3.2	8.6	4.2	2.8
CFPS	2,315	583	1,179	3,169	4,489
DPS	130	130	130	130	130

재무비율	(단위: 원, 배, %)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
성장성					
매출액 증가율	4.5	-50.1	38.1	104.5	48.7
영업이익 증가율	59.2	-94.5	694.2	288.9	48.7
순이익 증가율	94.3	적전	흑전	601.5	56.2
수익성					
ROIC	11.5	0.7	4.6	14.5	16.6
ROA	11.6	0.6	4.9	15.9	18.7
ROE	14.5	-4.2	4.2	25.7	30.9
안정성					
부채비율	98.8	125.4	143.6	147.2	129.2
순차입금비율	68.0	99.9	106.9	119.2	102.9
이자보상배율	14.3	0.6	0.0	0.0	0.0

자료: 테크윙, 대신증권 Research Center

재무상태표	(단위: 억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
유동자산	1,813	1,438	1,871	3,123	4,557
현금및현금성자산	233	136	311	48	24
매출채권 및 기타채권	536	401	319	651	977
재고자산	868	813	1,123	2,297	3,417
기타유동자산	175	88	117	127	139
비유동자산	3,070	3,421	3,488	3,786	4,067
유형자산	2,427	2,706	3,049	3,370	3,672
관계기업투자금	0	0	0	0	0
기타비유동자산	643	715	439	416	396
자산총계	4,883	4,859	5,358	6,909	8,624
유동부채	1,769	1,392	1,452	2,011	2,358
매입채무 및 기타채무	176	207	261	465	660
차입금	571	739	870	1,001	1,132
유동성채무	836	381	0	0	0
기타유동부채	187	66	322	545	566
비유동부채	658	1,311	1,706	2,103	2,503
차입금	558	1,202	1,582	1,962	2,342
전환증권	0	0	0	0	0
기타비유동부채	100	108	124	141	160
부채총계	2,427	2,703	3,158	4,114	4,861
자배지분	2,316	2,169	2,213	2,812	3,786
자본금	190	190	190	190	190
자본잉여금	408	408	408	408	408
이익잉여금	1,871	1,725	1,770	2,370	3,344
기타지분변동	-153	-154	-155	-155	-156
비자배지분	139	-13	-13	-17	-23
자본총계	2,456	2,156	2,200	2,795	3,763
순차입금	1,670	2,153	2,351	3,332	3,871

현금흐름표	(단위: 억원)				
	2022A	2023A	2024F	2025F	2026F
영업활동 현금흐름	821	204	177	-361	87
당기순이익	332	-111	94	660	1,031
비현금항목의 가감	544	329	346	524	646
감가상각비	112	103	121	140	157
외환손익	54	15	14	14	14
지분법평가손익	0	0	0	0	0
기타	378	211	211	370	475
자산부채의 증감	92	99	-237	-1,359	-1,299
기타현금흐름	-148	-113	-27	-186	-291
투자활동 현금흐름	-388	-672	-202	-453	-454
투자자산	-175	-182	250	0	0
유형자산	-85	-438	-438	-438	-438
기타	-128	-52	-14	-15	-16
재무활동 현금흐름	-400	374	82	463	463
단기차입금	-146	131	131	131	131
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	380	380	380	380
유상증자	-1	0	0	0	0
현금배당	-43	-46	-46	-46	-46
기타	-211	-91	-382	-2	-2
현금의 증감	31	-97	175	-263	-24
기초 현금	203	233	136	311	48
기말 현금	233	136	311	48	24
NOPLAT	449	27	196	762	1,133
FCF	420	-402	-123	460	849

[Compliance Notice]

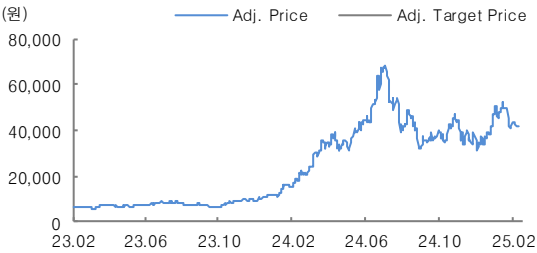
금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다.

(담당자:박장욱)

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

[투자의견 및 목표주가 변경 내용]

테크윙(089030) 투자의견 및 목표주가 변경 내용



제시일자	25.02.18
투자의견	
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	
제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	
제시일자	
투자의견	
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	
제시일자	00.06.29
투자의견	
목표주가	
과리율(평균%)	
과리율(최대/최소%)	

투자의견 비율공시 및 투자등급관련사항(기준일자:20250215)

구분	Buy(매수)	Marketperform(중)	Underperform(매도)
비율	93.7%	6.3%	0.0%

산업 투자의견

- Overweigh(비중확대)
: 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 초과 상승 예상
- Neutral(중립)
: 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 예상
- Underweigh(비중축소)
: 향후 6개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 하회 예상

기업 투자의견

- Buy(매수)
: 향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 상승 예상
- Marketperform(시장수익률)
: 향후 6개월간 시장수익률 대비 -10%p~10%p 주가 변동 예상
- Underperform(시장수익률 하회)
: 향후 6개월간 시장수익률 대비 10%p 이상 주가 하락 예상